

株式会社東京精密 2023年度(2024年3月期) 第3四半期 決算説明会

2024年2月5日

◆ **将来の事象に係わる記述に関する注意**

- 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ **表記データ・用語について**

- 注記がある場合を除き、**半導体製造装置セグメント**を「半導体」、**精密計測機器セグメント**を「計測」、また**親会社株主に帰属する当期純利益**を「当期純利益」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。
- 2022年度より、在外子会社の収益及び費用は、従来の期末レートから期中平均レートにより円換算する方法に変更しております。これに伴い、補足資料の2021年度の数値は、期中平均レートを遡及適用した数値を記載しております。

◆ **2023年度第2四半期のセグメント利益の訂正について**

- 2023年11月2日に開示しました2023年度第2四半期の業績について、半導体製造装置、精密計測機器セグメントの営業利益に誤りがあることが判明しましたので、訂正いたしました。なお、全社業績への影響はございません。詳しくは本日の開示資料をご覧ください。

◆ **監査について**

- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

2024年3月期 第3四半期決算説明会(Web開催)

当社 出席者：

代表取締役副社長CFO 川村 浩一

経営支援室 IRチームリーダー 高嶋 直樹

- 決算の説明に先立ちまして、皆様にご案内がございました。
- 第3段落目に記載のように、この第3四半期の連結計算の過程で、11月に開示した 第2四半期の各セグメントの営業利益に誤りがあることが判明しましたので、訂正いたしました。なお、全社業績への影響はございません。詳しくは、本日 開示いたしました資料をご覧ください。大変申し訳ございません。

2023年度 第3四半期 連結業績



累計業績(億円)	2022年度		2023年度	
	第3四半期(累計)		第3四半期(累計)	前年同期比
受注高	1,103		896	-19%
売上高	1,031		889	-14%
営業利益 (営業利益率)	231 (22%)		144 (16%)	-38%
経常利益	237		151	-36%
当期純利益	152		106	-30%

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	前四半期比	前年同期比
受注高	462	340	301	260	295	299	301	+1%	+0%
売上高	279	432	320	437	266	369	254	-31%	-21%
営業利益 (営業利益率)	57 (20%)	100 (23%)	74 (23%)	114 (26%)	43 (16%)	71 (19%)	30 (12%)	-58%	-60%
経常利益	65	101	71	116	47	74	30	-59%	-58%
当期純利益	48	71	33	84	32	53	21	-61%	-38%

- 売上高・各利益は、社内計画の範囲内での減少（4Q売上増加の計画）
- 3Q 受注高は、前年同期並み

Feb 5th, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

3

- CFOの川村です。日頃大変お世話になっております。
- それでは決算概要を説明いたします。
上段、2023年度第3四半期累計の業績は、受注高 896 億円、売上高 889 億円、営業利益 144 億円、営業利益率は16%、経常利益 151 億円、親会社株主に帰属する当期純利益 106 億円となり、前年同期比減収減益の着地となりました。
- 下段は四半期ごとの実績です。
第3四半期の実績は、概ね顧客納期を踏まえた社内想定範囲内での着地となりました。売上は第4四半期に集中する社内計画となっております。
- 次にセグメント別に説明いたします。

セグメント業績 (累計：億円)	2022年度		2023年度	
	第3四半期(累計)		第3四半期(累計)	前年同期比
受注高	818		625	-24%
売上高	795		645	-19%
営業利益 (営業利益率)	203 (26%)		109 (17%)	-46%

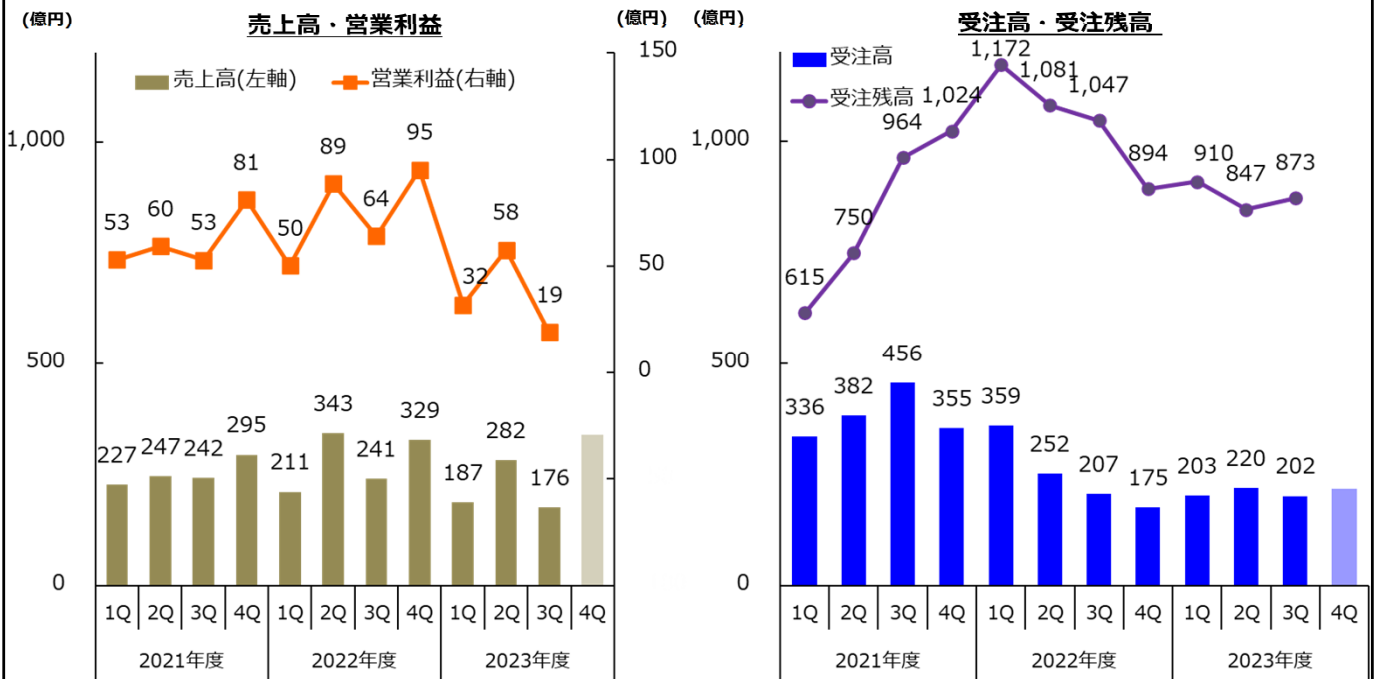
四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	前四半期比	前年同期比
受注高	359	252	207	175	203	220	202	-8%	-2%
売上高	211	343	241	329	187	282	176	-38%	-27%
営業利益 (営業利益率)	50 (24%)	89 (26%)	64 (27%)	95 (29%)	32 (17%)	58 (20%)	19 (11%)	-67%	-70%

注：第2四半期の営業利益を訂正しております。

- 売上高・営業利益は、想定内での着地
- 3Q受注は、民生関係需要の低迷が続いたものの、生成AI等が下支え

- こちらは、半導体製造装置セグメントの業績です。
- 第3四半期 累計業績は、
受注高 625 億円、売上高は 645 億円、営業利益は 109 億円となりました。
営業利益率は 17 %でした。
- 四半期業績は下段に記載のとおりです。
第3四半期の受注高は、民生関係の装置需要が一段と弱含むなか、
生成AIなど、一部の堅調な分野からの引合いが続き、前年同期なみとなりました。
- 売上高は、当初より第4四半期に集中する計画となっており、概ね想定線の着地です。
なお、第4四半期の出荷予定も固まってきたことから、下期の売上予想を、若干ですが
修正しています。

半導体 - 四半期業績推移



- 売上高・営業利益：4Qは3Q比で大幅増収を見込む
- 受注・受注残高：民生関係需要の軟調が続くも、生成AI案件などが下支え

Feb 5th, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

5

- こちらは、売上高などの四半期推移です。
- 左側は売上高と営業利益の推移です。
 売上高は第4四半期に増加すると見込んでおります。
 これに伴って下期売上予想を若干修正することについては、先ほど申し上げた通りです。
- 右側、受注高ですが、民生関係需要の弱さが続く中
 生成AIなど、一部の堅調な分野からの引合いは第3四半期も続きました。
 第4四半期も生成AI関連の受注を見込んでおりますが、
 民生の軟調さもありますので、受注高は第3四半期比で10%程度の増加になると
 想定しております。

セグメント業績 (累計：億円)	2022年度		2023年度	
	第3四半期(累計)		第3四半期(累計)	前年同期比
受注高	285		272	-5%
売上高	236		243	+3%
営業利益 (営業利益率)	28 (12%)		35 (14%)	+25%

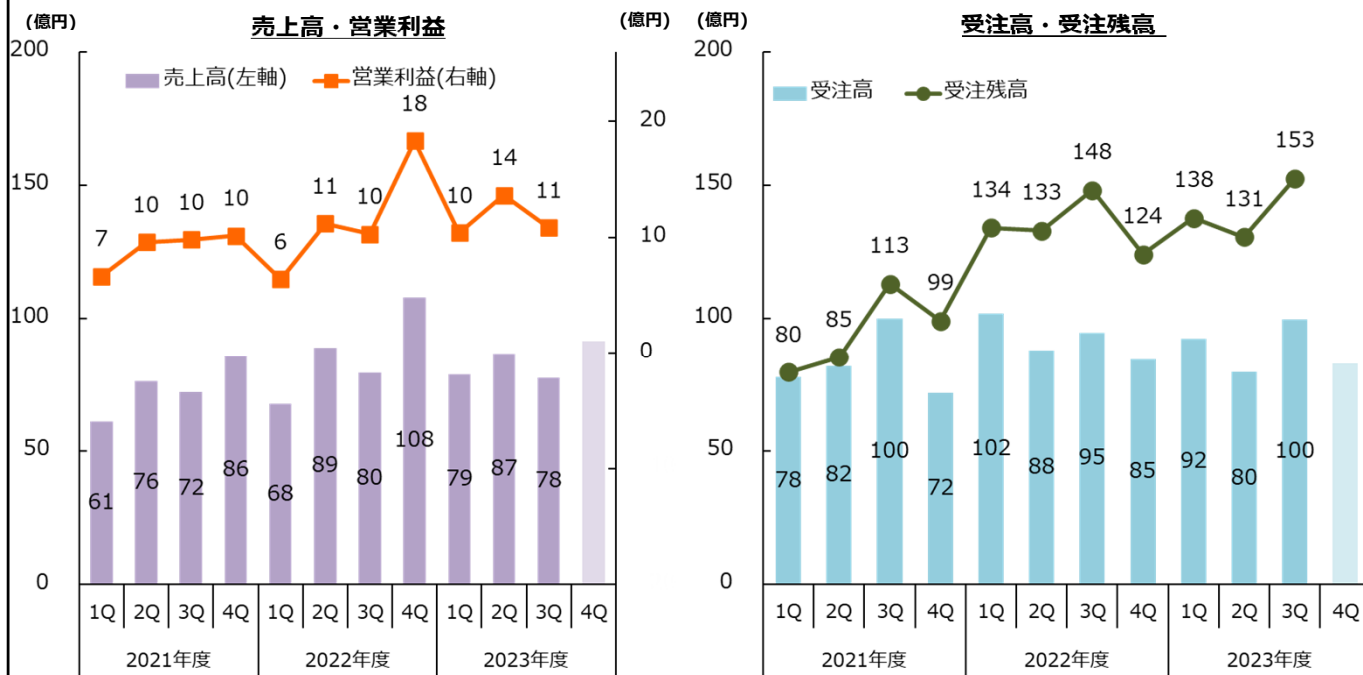
四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	前四半期比	前年同期比
受注高	102	88	95	85	92	80	100	+25%	+5%
売上高	68	89	80	108	79	87	78	-10%	-2%
営業利益 (営業利益率)	6 (10%)	11 (13%)	10 (13%)	18 (17%)	10 (13%)	14 (16%)	11 (14%)	-21%	+5%

注：第2四半期の営業利益を訂正しております。

- 売上高は、出荷が概ね想定通り進み、前年同期なみの着地
- 3Q受注は、前四半期比、前年同期比で増加

- 続いて、計測機器セグメントの業績です。
- 上段、第3四半期累計業績は、
受注高 272 億円、売上高は 243 億円、営業利益は 35億円、営業利益率は 14%でした。
- 四半期業績は、下段の通りです。
第3四半期の受注は 前四半期比、前年同期比で増加しています。

計測 - 四半期業績推移



- 売上高・営業利益：生産・出荷が計画通り進捗
- 受注・受注残高：季節性に加え、一部製品の価格改定に伴う駆け込み需要がみられた

Feb 5th, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

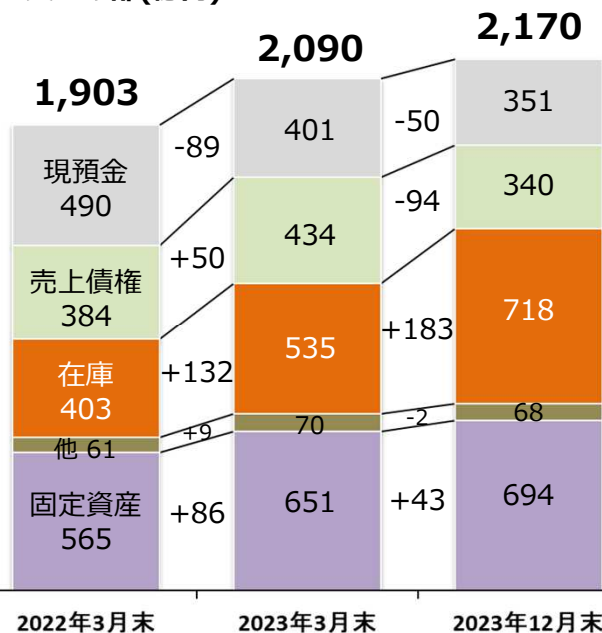
7

- こちらは、計測の四半期推移グラフです。
- 左側、売上高ですが、第3四半期の着地は、概ね想定線です。
- 右側、受注高について、第3四半期は、季節性による増加に加え、一部製品の価格改定に伴う駆け込みの受注がありました。なお、第4四半期の受注高は、駆け込みの反動減や季節性により第3四半期比で20%弱の減少を想定しております。

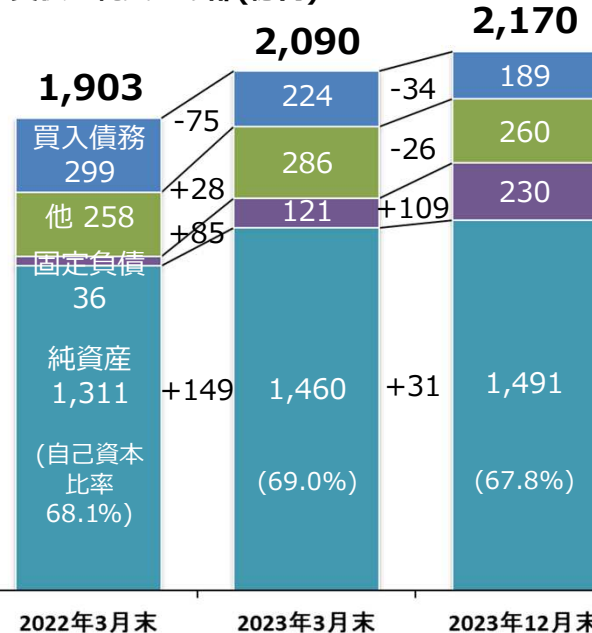
貸借対照表



資産の部(億円)



負債・純資産の部(億円)



- 資産の部：4Q以降の出荷増を踏まえ、在庫が増加
- 負債・純資産の部：設備資金需要などを踏まえた借入実施により、固定負債が増加

Feb 5th, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

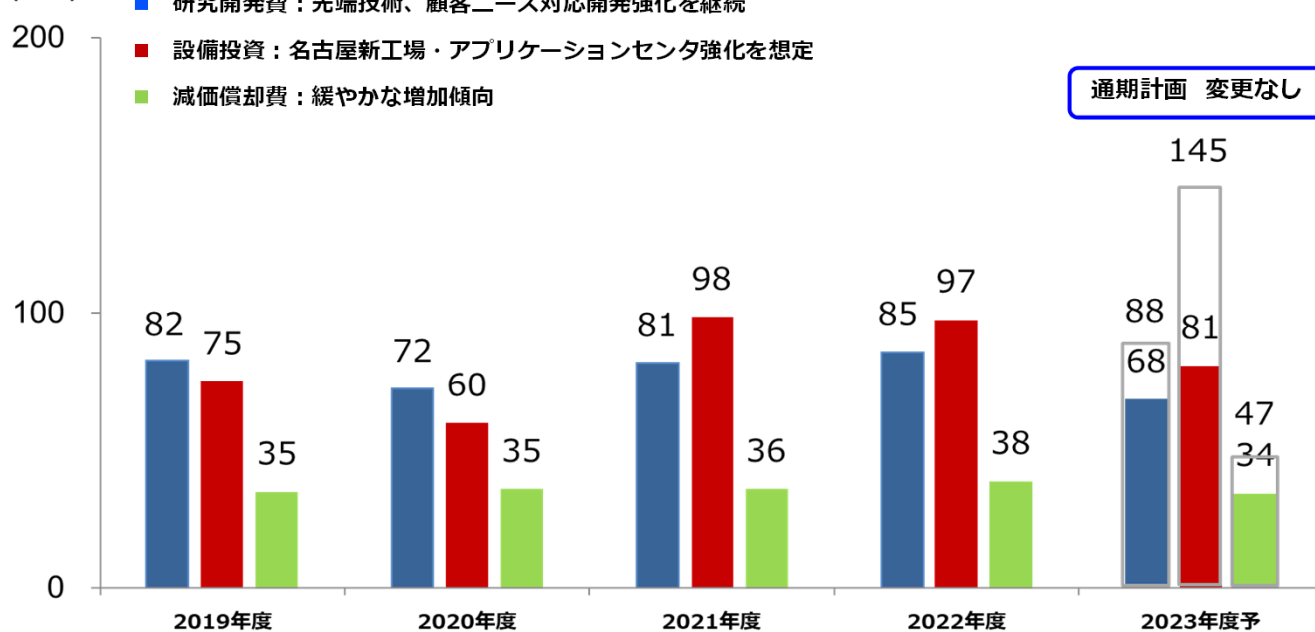
8

- こちらは貸借対照表の概要となります。
- 2023年12月末の総資産は、2,170 億円となりました。
- 左の資産の部ですが、在庫が引き続き増加しています。
これは、第4四半期、ならびに今後の売上増に備えたものです。
- 右側、負債の部ですが、
在庫増に加え、名古屋工場などの設備資金需要を踏まえた借入の実施により
固定負債が増加しました。
- 12月末の自己資本比率は 67.8%となりました。

試験研究費、設備投資、減価償却



(億円)



➤ 名古屋工場：2025年竣工に向け計画通り進捗

Feb 5th, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

9

- こちらは、試験研究費や設備投資の実績と、今年度計画となります。
- 第3四半期累計の試験研究費は、68億円となりました。
- 設備投資の実績は81億円です。
この第4四半期に、2025年竣工予定の名古屋工場に関する支出を見込んでおり、通期の設備投資は期初計画通りでの着地を見込んでいます。
- 減価償却は、34億円となりました。
飯能工場が昨年竣工したことにより、今年度償却費は前年同期比で増加しており今後も緩やかな増加傾向を想定しています。
- ここまでが、実績の説明です。

全体

- 今後の成長を見据え 必要な研究開発・設備投資を継続

半導体

- 堅調な分野 (AI, HBM, Hybrid Bonding, SiC, CIS, 中国需要)が短・中期需要を牽引
- 民生関連需要は一段と停滞

計測

- 顧客の投資決定に先送り傾向あり
- 充放電試験システムの販路拡大を進める
- 非自動車分野への拡販や、自動化向けソリューション強化を進める

- こちらは 2023年度の業績予想の前提となります。
11月の説明会で開示した資料に、青字でアップデートを入れております。
- まず全体感ですが、次のサイクルで 大きな成長が実現できるとの考えは変わらず
このために必要な研究開発・設備投資は計画通り進めてゆく所存です。
- 半導体については、生成AI、HBMなど、足許で需要活発な分野が、
短期、中期の業績の下支えになるという考えに変更はありません。
一方で、民生は一段と停滞しており、回復のタイミングを注視しています。
- 計測では、様々な業界で設備投資の先送りの傾向がみられますが、
充放電試験システム事業に注力し、販路拡大を進めています。

2023年度 業績予想



連結業績 (億円)	2022年度		2023年度		
	通期		通期予(今回)	前回予想比	前期比
売上高	1,468		1,330	+10	-9%
営業利益 (営業利益率)	345 (24%)		250 (19%)	+5	-28%
経常利益	353		258	+4	-27%
当期純利益	236		180	+2	-24%
1株配当	235円		178円	±0円	-57円

セグメント別 四半期業績	2022年度				2023年度				4Q予	前回予想比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q			
(半導体) 受注高	359	252	207	175	203	220	202			
(半導体) 売上高	211	343	241	329	187	282	176	350	+10	
(計測) 受注高	102	88	95	85	92	80	100			
(計測) 売上高	68	89	80	108	79	87	78	91	±0	

- 2023年11月2日に開示した通期業績予想を修正 (半導体売上高を上方修正)
- 両セグメントとも、4Qは3Q比で増収を計画
- 為替前提 1ドル = 140円 (変更なし)

Feb 5th, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

11

- 以上の前提と、足許の出荷計画などを踏まえ、昨年11月に開示した2023年度通期業績予想を若干修正しました。
- 半導体で、前回予想よりも出荷が増加すると見込まれるため、売上高で10億円、営業利益で5億円 上方修正しました。計測の業績予想は据え置いております。
- 年間配当予想、ならびに為替前提に変更はありません。
- 以上が当社からの説明となります。ご清聴 ありがとうございました。



IR情報



<https://www.accretech.com/jp/ir/index.html>

サステナビリティ情報



<https://www.accretech.com/jp/sustainability/index.html>

補足資料

Supplementary Data

セグメント別業績推移 Segment Information



(百万円) Million Yen		会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
		2020年 3月期 FY2020/3	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2023年3月期 FY2023/3				2024年3月期 FY2024/3			
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
敬社 高	半導体 SPE	57,709	93,181	152,896	99,366	35,918	25,246	20,663	17,537	20,345	21,957	20,175	
	計測 Metr.	29,866	23,878	33,159	36,960	10,246	8,788	9,472	8,452	9,225	7,981	9,963	
	合計 Total	87,576	117,060	186,056	136,326	46,165	34,034	30,136	25,990	29,571	29,938	30,139	
敬社 低	半導体 SPE	29,182	50,619	102,370	89,371	117,153	108,134	104,714	89,371	90,993	84,710	87,300	
	計測 Metr.	7,782	6,301	9,904	12,428	13,367	13,263	14,782	12,428	13,758	13,061	15,253	
	合計 Total	36,965	56,920	112,274	101,799	130,520	121,398	119,496	101,799	104,752	97,771	102,553	
敬社 中	半導体 SPE	56,198	71,745	101,145	112,365	21,135	34,264	24,084	32,880	18,722	28,241	17,585	
	計測 Metr.	31,728	25,359	29,556	34,436	6,783	8,892	7,954	10,806	7,895	8,678	7,772	
	合計 Total	87,927	97,105	130,702	146,801	27,919	43,156	32,038	43,687	26,618	36,919	25,357	
敬社 低	半導体 SPE	7,915	13,565	24,698	29,866	5,049	8,874	6,416	9,526	3,208	5,773	1,912	
	計測 Metr.	4,366	1,996	3,628	4,628	641	1,120	1,031	1,834	1,042	1,365	1,084	
	合計 Total	12,282	15,562	28,327	34,494	5,691	9,994	7,448	11,361	4,250	7,138	2,997	
敬社 低	半導体 SPE	14.1%	18.9%	24.4%	26.6%	23.9%	25.9%	26.6%	29.0%	17.1%	20.4%	10.9%	
	計測 Metr.	13.8%	7.9%	12.3%	13.4%	9.5%	12.6%	13.0%	17.0%	13.2%	15.7%	14.0%	
	合計 Total	14.0%	16.0%	21.7%	23.5%	20.4%	23.2%	23.2%	26.0%	16.0%	19.3%	11.8%	

損益計算書 Statements of Income



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
	2020年 3月期 FY2020/3	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2023年3月期 FY2023/3				2024年3月期 FY2024/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高 Net Sales	87,927	97,105	130,702	146,801	27,919	43,156	32,038	43,687	26,618	36,919	25,357	
売上原価 Cost of goods sold	53,452	60,190	77,694	84,967	15,940	25,783	18,220	25,022	15,415	22,387	14,894	
売上総利益 Gross Profit on Sales	34,474	36,914	53,008	61,834	11,978	17,372	13,817	18,664	11,203	14,531	10,462	
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	22,192	21,351	24,681	27,339	6,287	7,378	6,369	7,303	6,952	7,392	7,465	
営業利益 Operating profit	12,282	15,562	28,327	34,494	5,691	9,994	7,448	11,361	4,250	7,318	2,997	
営業外収益 Non-operating income	255	540	987	965	824	96	-229	274	563	245	52	
営業外費用 Non-operating expenses	177	235	153	162	18	25	111	7	103	22	64	
経常利益 Recurring Profit	12,360	15,867	29,160	35,297	6,496	10,065	7,107	11,628	4,710	7,361	2,985	
特別利益 Extraordinary gains	57	1,354	390	103	5	58	12	25	26	-	3	
特別損失 Extraordinary losses	1,712	1,074	34	2,099	-	-	1,751	347	-	14	-	
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	10,705	16,147	29,516	33,301	6,502	10,124	5,368	11,306	4,736	7,347	2,989	
法人税等合計 Total Income tax and others	3,598	3,978	8,132	9,607	1,660	3,019	2,011	2,916	1,456	1,998	897	
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	7,156	12,175	21,326	23,630	4,812	7,096	3,338	8,383	3,245	5,302	2,067	
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (Yen)	171.89	293.83	522.52	581.33	118.38	174.47	82.05	206.60	80.63	131.49	51.23	
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	170.72	291.43	517.51	575.62	-	-	-	-	-	-	-	-

Feb 5th, 2024

Copyright 2024 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

15

貸借対照表 Balance Sheet



(百万円) (Million Yen)		2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期(3Q末) FY2024/3 (3Q)
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	43,657	49,033	40,080	35,055
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	30,946	38,367	43,403	33,957
	在庫 Inventories	32,886	40,325	53,482	71,782
	その他 Others	4,025	6,103	7,005	6,773
	合計 Total	111,516	133,829	143,972	147,567
固定資産合計 Total Fixed Assets		50,039	56,457	65,060	69,418
総資産 Total Assets		161,556	190,287	209,032	216,986
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	23,062	29,876	22,359	18,947
	その他 Others	16,233	25,765	28,588	25,953
	合計 Total	39,296	55,641	50,947	44,900
固定負債合計 Total long-term liabilities		5,482	3,564	12,057	22,980
負債合計 Total Liabilities		44,778	59,206	63,004	67,880
純資産合計 Total Net Assets		116,777	131,081	146,028	149,105
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets		161,556	190,287	209,032	216,986
有利子負債合計 Total interest-bearing debt		7,581	5,497	14,191	26,151
自己資本比率 Equity Ratio(%)		71.4%	68.1%	69.0%	67.8
自己資本利益率 ROE(%)		10.9%	17.4%	17.3%	-

※1: 電子記録債権、契約資産を含む

Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む

Incl. Electronically recorded obligations-operating

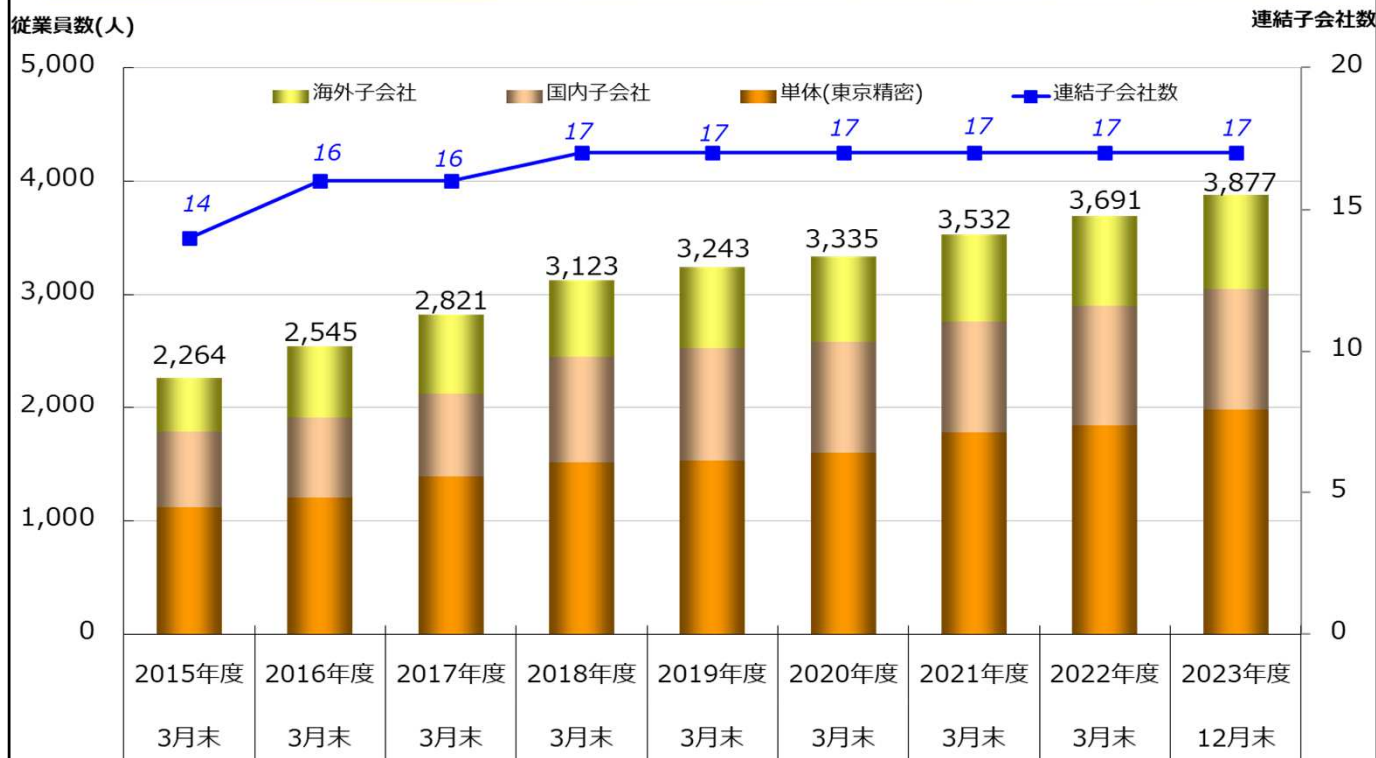
各種費用, キャッシュフロー Expenses and Cash Flows



(百万円) (Million Yen)	2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期(3Q累計) FY2024/3(3Q)
試験研究費 R&D expenses	7,193	8,146	8,542	6,828
設備投資 Capex	5,950	9,793	9,725	8,057
減価償却費 (のれん除く) Depreciation (excl. Amortization)	3,516	3,551	3,832	3,359

(百万円) (Million Yen)	2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期(上期) FY2024/3(1H)
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	22,062	23,837	1,000	1,832
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-5,191	-8,990	-8,421	-6,498
フリーキャッシュフロー Free cash flows	16,871	14,846	-7,421	-4,665
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-8,282	-10,346	-2,174	-7,821
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	429	882	625	559
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	43,624	49,006	40,036	28,108

従業員数推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算